

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

上海骄成超声波技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-014

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☒其他（策略会）
参与单位名称及人员姓名	国联民生证券、平安资产、财通基金、国华兴益资管、泓德基金、银河基金、西部利得基金、华泰保兴基金、易方达基金、天治基金、亘曦基金、仙人掌私募、恒越基金、光大资管、利位投资、景和资产、华泰资管
会议时间	2025 年 10 月 14 日
会议地点	上海
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：彭芹芹
投资者关系活动主要内容介绍	Q1、请问公司在半导体先进封装领域的产品和进展情况如何？ A1、在功率半导体领域，公司有超声波端子焊接机、超声波PIN 针焊接机、超声波键合机、超声波扫描显微镜等全工序超声波解决方案，并均已实现批量出货。在该领域，公司与上汽英飞凌、中车时代、振华科技、宏微科技、士兰微、芯联集成等知名企业保持良好合作。在半导体先进封装领域，公司大力推动先进超声波扫描显微镜以及超声波固晶机（超声热压焊机）等新产品设备的研发和推广；在该领域，公司可应用于半导体晶圆级封装、2.5D/3D 封装、面板级封装等产品检测的先进超声波扫描显微镜，成功获得了国内知名客户正式订单并完成交付；超声波固晶机（超声热压焊机）已获得客户正式订单。

	公司先进封装相关业务正持续突破技术与市场边界,加速向规模化应用迈进。 Q2、请问公司超声波检测有哪些优势以及与其他检测方式的区别? A2、在半导体先进封装领域,超声波检测与光学检测、X 射线等检测技术互为补充。超声波检测的核心优势在于其穿透能力和对内部界面缺陷的无损量化能力,尤其在半导体晶圆、2.5D/3D 封装、芯片贴装等关键工艺中的内部缺陷问题。光学检测、电子束检测等适用于工件表面缺陷检测;超声波检测与X 射线则能够检测工件内部缺陷,X 射线检测的优势在于检测存在密度差异的缺陷,超声波检测则对声阻抗差异敏感,对于内部的平面型缺陷或界面缺陷,如裂纹、未熔合、界面分层等情况,超声波的反射特性优势明显,超声波在界面会大量反射,产生极其强烈的回波信号,利用界面声阻抗差异,超声波检测技术可精准、无损伤地探测出半导体晶圆、2.5D/3D 封装、芯片贴装等内部缺陷。 Q3、请问超声波固晶机等产品进展情况? A3、公司积极布局 IC 封装领域,着力研发高端超声波固晶机及球焊机。超声波球焊机运用超声波焊线技术,通过施加压力、热与超声,使微细金线精准连接 IC 芯片电极与框架焊盘,完成芯片封装前的内部引线焊接。依托公司在超声波领域多年技术积淀与经验丰富的研发团队,目前该设备设计与开发工作进展顺利,旨在突破海外厂商在该领域的长期垄断局面。 Q4、公司固晶机与传统固晶机的区别以及超声波固晶有哪些优势? A4、传统固晶机主要依赖外部加热和机械压力实现机械连接和电气连接。超声波固晶机则在此基础上进一步引入了超声波能量,在压力下超声波振动传递到芯片与基板的接触界面使金属原子间相互扩散,形成牢固的金属键合。与传统工艺相比,
--	--

	公司超声波热压固晶机采用自主创新的超声波键合技术,通过高频超声波振动,在芯片与基板界面处产生局部加热并清除表面氧化物,促使材料原子级扩散和接触。在超声能量与精确压力协同作用下,界面发生塑性形变和原子扩散,形成牢固的金属键合,大幅提升封装可靠性和生产效率。公司超声波热压固晶机仅需较低预加热温度,即可实现优质键合效果,可以降低热敏感元件损伤风险,具有效率高、能耗低等显著优势,在光通讯、5G 射频、滤波器、激光器、分立器件、存储、AR/VR、MEMS 等领域具有较大的应用前景。 Q5、线束连接器领域有哪些客户? A5、在线束连接器领域,公司超声波焊机主要应用于新能源汽车高低压线束、充电桩、储能场景等,与莱尼、泰科电子、安波福、安费诺、住友等以及比亚迪、中航光电、沪光股份、均胜电子、长春捷翼、华丰科技、永贵电器、天海电器、立讯精密、沃尔核材等知名企业保持良好合作。 Q6、公司在医疗领域有哪些产品和规划? A6、公司有序推进医疗领域产品布局,目前已取得超声波口腔医疗器械注册证 5 项,相关产品落地进程持续加速,部分超声波口腔设备也有望年内实现销售,相关中高端应用等产品在积极布局中。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 10 月 15 日